

非破壊試験による内部構造確認、欠陥評価

非破壊で内部構造を徹底調査！

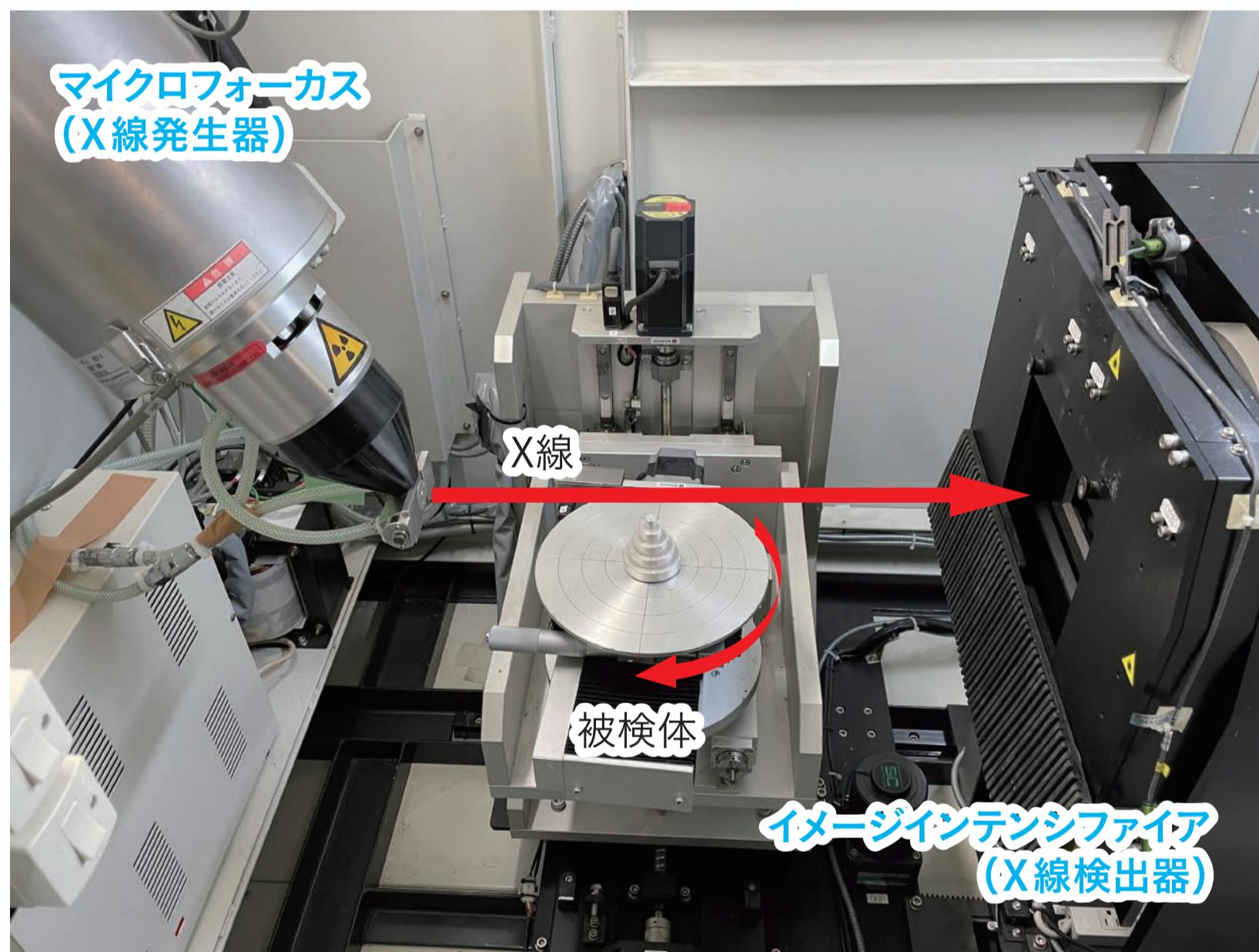
X線CTおよびX線透過像により

製品調査や不具合品調査、リバースエンジニアリングにおける内部構造、欠陥部の確認を実施致します。

また使用される素材ごとに色分けされた3次元での画像も作成可能です。

X線CT

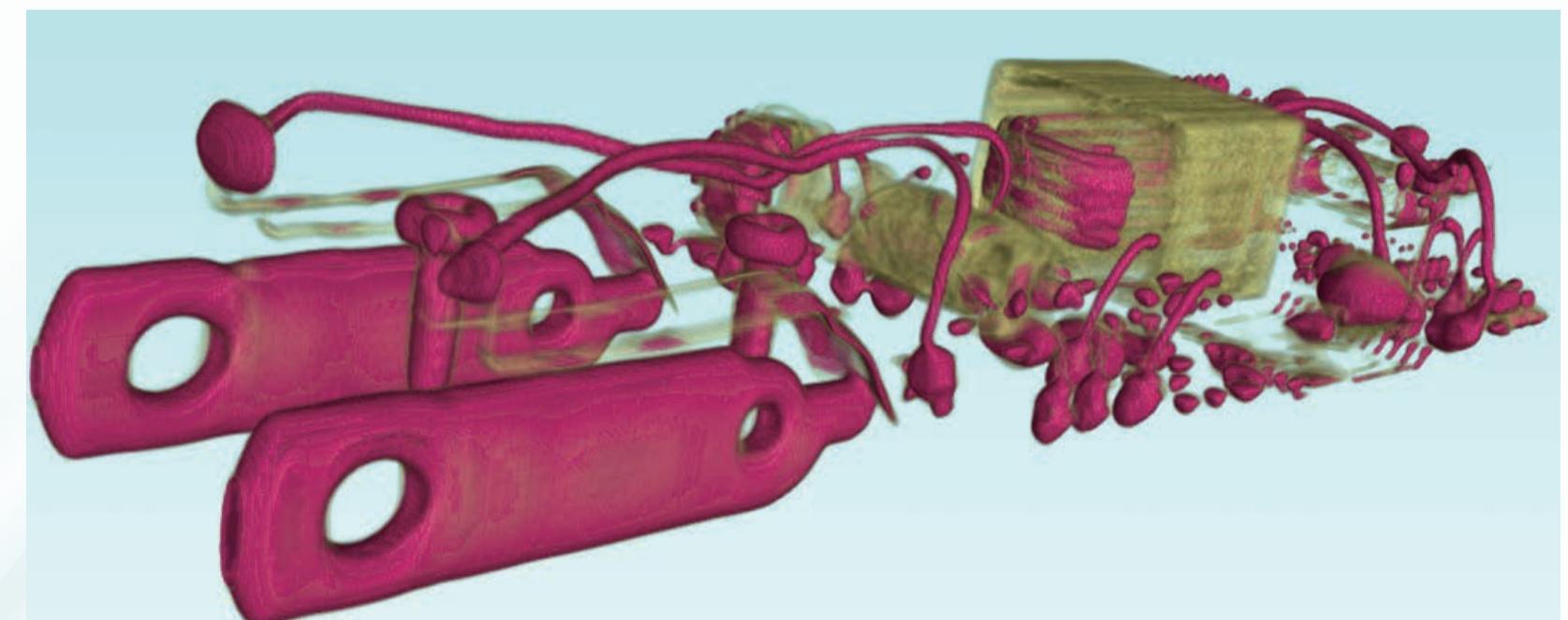
- 被検体の3次元構成画像を作成可能
- 拡大X線CT撮影も可能
- 被検体の材質、大きさに合わせたX線CT撮影をご提案



3D化(3次元構成画像)

- CT値と呼ばれる画像情報を変化させることにより、物質毎の表示をすることができます

例)急速充電器:金属部、樹脂部の2色表示



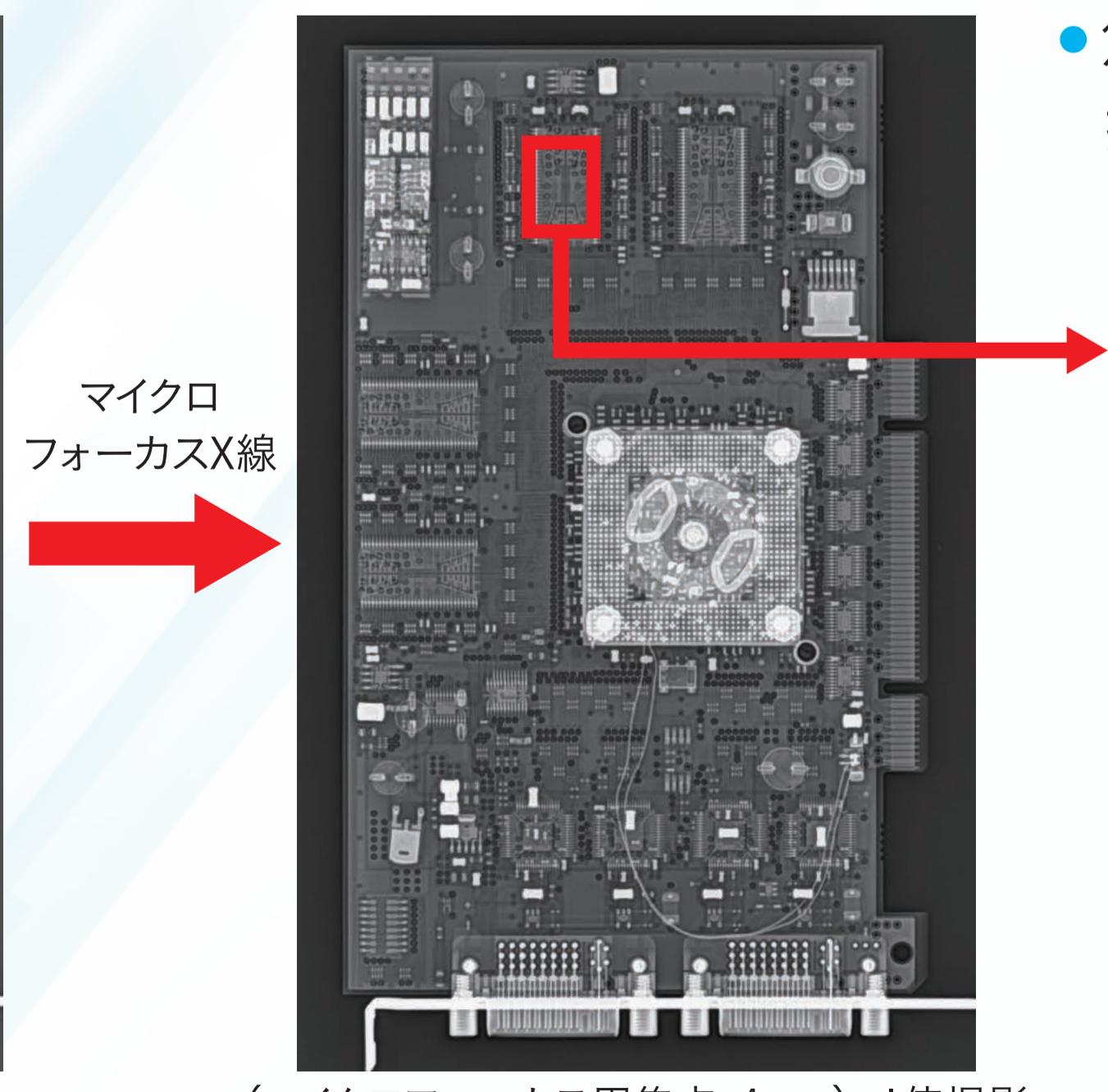
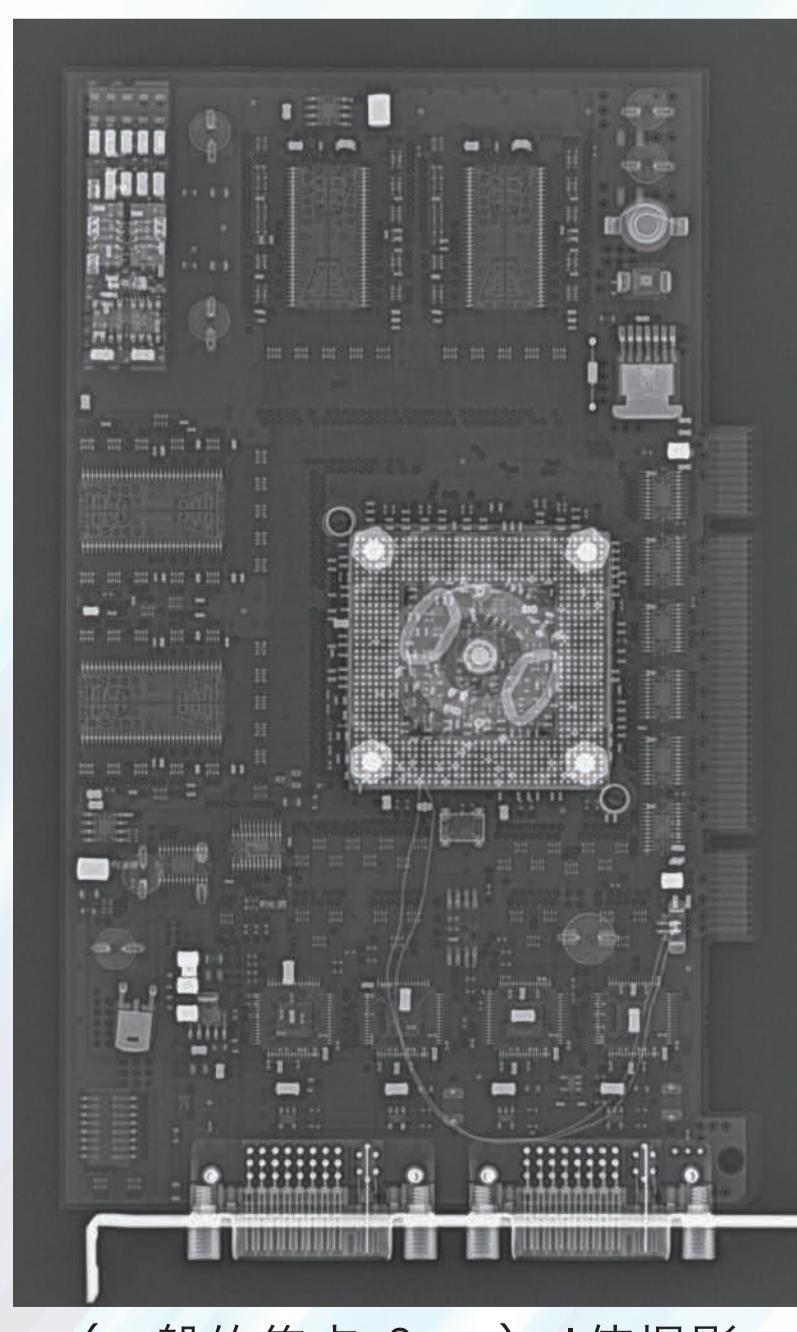
マイクロフォーカスX線CT仕様

X線CTでの対応寸法: $\phi 200 \times H250\text{mm}$ 、4kgまで
解像度: $30\mu\text{m}$ 、適応板厚: 約15mm(鉄換算)

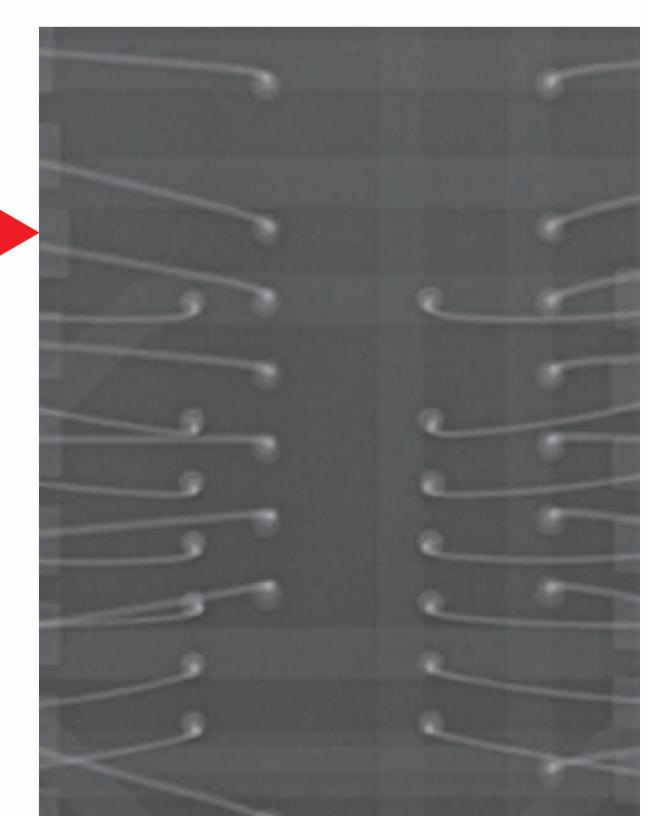
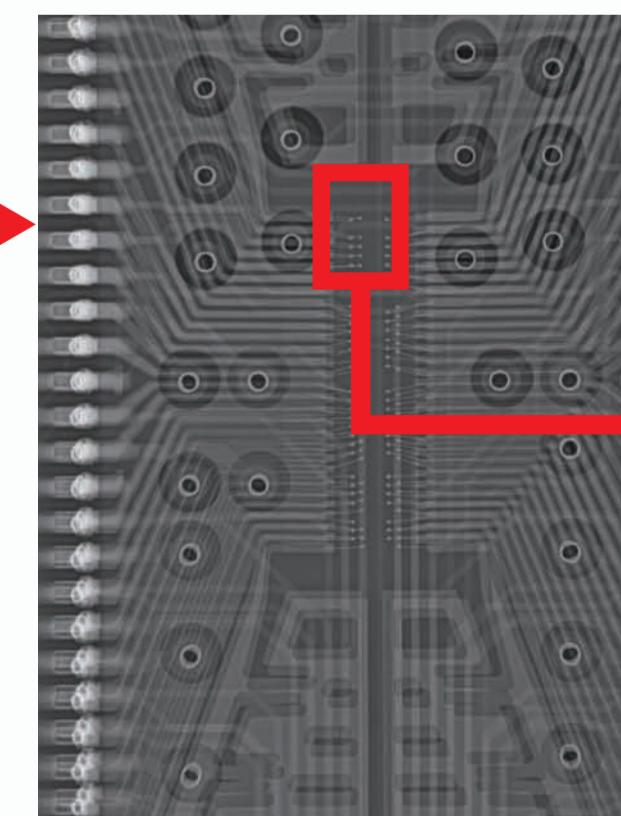
実績(一例)

- ターボチャージャー
- 樹脂内ボイドの有無確認
- 金属溶接キズの確認
- 割れ断線、異物の確認

拡大X線透過像(マイクロフォーカス)



- 焦点が小さいマイクロフォーカスX線により拡大して撮影が可能。



(分解能: $4\mu\text{m}$ 、最高倍率: 100倍)